

接着剤不要の接合革命 6G時代を支える次世代接着ソリューション

主催：MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）、地方独立行政法人大阪産業技術研究所

開催日 **令和6年 12/18（水）**

時間 **15:30 ~ 17:00**

セミナー終了後、名刺交換会を予定しています。※参加は任意です。

会場 **MOBIO 309会議室（クリエイション・コア東大阪 北館3F 309号室）**

東大阪市荒本北1-4-17（近鉄けいはんな線「荒本駅」1番出口から北西に徒歩5分）

（大阪メトロ中央線「長田駅」3番出口から北東に徒歩10分）

講師 **地方独立行政法人 大阪産業技術研究所**

電子材料研究部 総括研究員 小林 靖之 氏

本セミナーでは、6G時代に求められる高性能かつ持続可能な接着技術に焦点を当て、接着剤を使用しない「究極の接着技術」の原理とその応用について紹介します。

次世代通信インフラを支える電子部品、特に半導体パッケージやプリント配線板には、100GHz帯の高周波に対応する材料および製造プロセスが必要です。信頼性の高い異種材料の接着は、その製造に欠かせない要素技術であり、近年、分子レベルでの接合技術が急速に進展しています。本技術は、従来の接着剤を超える新たな接着メカニズムにより、信頼性向上、環境負荷の低減、製造プロセスの効率化を実現します。さらに、業界の新たな標準となる可能性を秘めた技術の未来展望についても議論します。

参加費無料

定員 30名

**ものづくり中小企業、
支援機関等対象**

お申込み

右のQRコードよりお申込みください。

申込締切：12月16日（月）

お問合せ先

大阪府 商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課 南・鮎子田

TEL：06-6210-9470



申込はこちら

CHECK!

MOBIO Cafe

検索

から「MOBIO Cafe 開催案内一覧」をご覧ください。

<https://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe>

※ご記入いただいた個人情報は、主催者間で共有するとともに、当日の受付・連絡、本イベントの目的及び今後の調査並びにイベント情報の提供のために使用し、他の目的には使用しません。（MOBIOは大阪府・（公財）大阪産業局の2者で運営しています。）

※専用の駐車場がありませんので、お車でお越しの際は近隣の有料駐車場をご利用ください。